

## MES 系統委託單注意事項: 2024/12/04 更新

### 1. 委託操作服務規範與計費

- (1) 樣品尺寸：破片(需大於 2cm\*2cm)至 8 吋製程。
- (2) 可進機台之基板，目前僅限 Si 及玻璃；可進機台之材料，如 Si、Ge、SiOx、SiNx、SiC，**禁止**進有機薄膜，如 polymer 等，其餘材料請詢問機台負責人。
- (3)計費方式:破片 30 分鐘/片，全片 wafer 60 分鐘/片，計費方式是以片計算。
- (4)特殊製程委託者必須全程在場，並事先完成 TSRI 職業安全訓練取得通過證明。
- (5)製程申請表請使用無塵紙，並提供製程條件；**自取請註明。**

### 2. 委託操作服務樣品數量

- (1) 全片樣品，如 6 吋或 8 吋，可提供單片最多 2 個雷射功率。
- (2) 破片樣品需大於 2cm\*2cm，每片樣品僅限 1 個雷射功率。
- (3) 每張委託操作服務單:不同雷射功率最多僅限 3 個功率與 12 個樣品；相同雷射功率，每張委託操作服務單最多 25 個樣品。
- (4)代工出貨:三天出貨 5 片全片 8"、6" wafer(若遇假期順延)或破片 12 個樣品。
- (5) 於委託單備註上提供雷射種類、結晶(C)/活化(A)、功率、使用材料，CO2 雷射請提供升溫溫度/不升溫。**EX: GLA 3w Si/SiO2/a-Si。**

結晶與活化差別在於，雷射的步進間隔不同:\*結晶:0.35 (mm) \*活化: 0.8(mm)

### 3. 委託操作服務雷射功率範圍(其餘範圍請與工程師討論)

- 藍光雷射功率：介於 1 W 至 3.0 W 之間，間隔 0.25 W
- 綠光雷射功率：介於 1 W 至 10 W 之間，間隔 0.5 W
- CO2 雷射功率: 介於 70 W 至 130 W 之間，間隔 10 W
- **CO2 雷射請在委託單提供升溫溫度/不升溫。標準活化製程:350 °C**